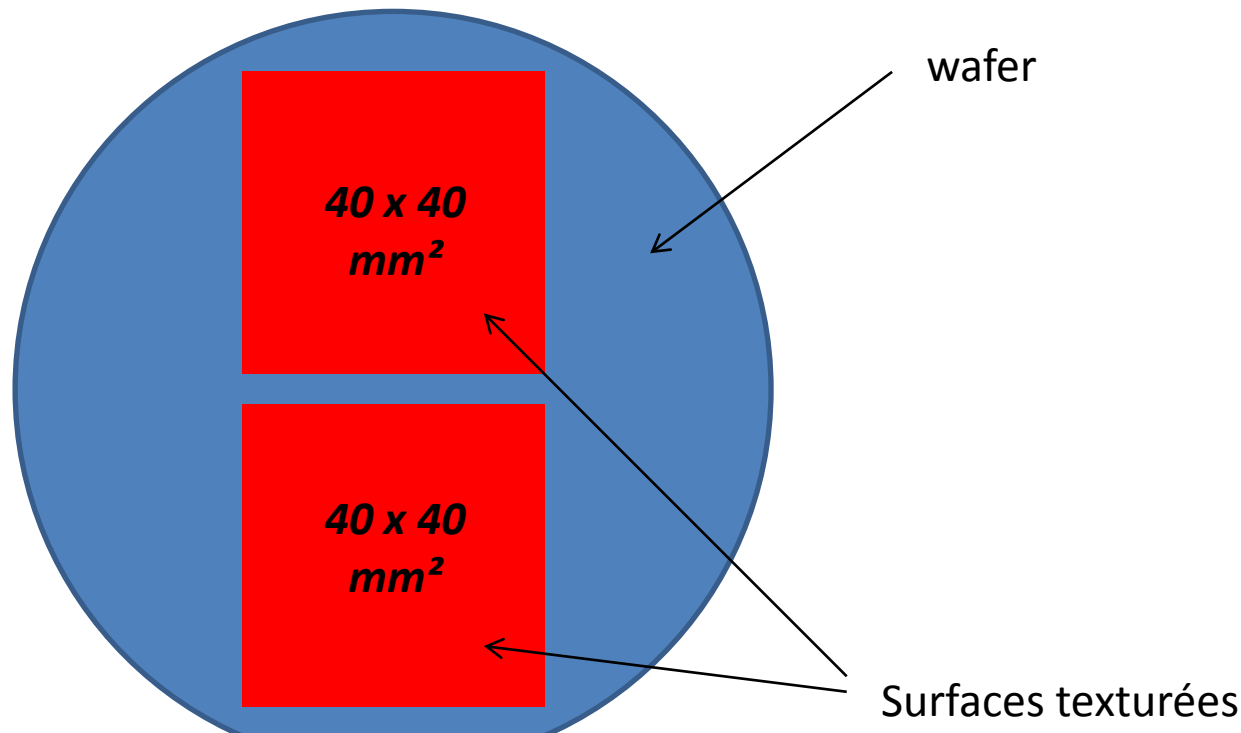
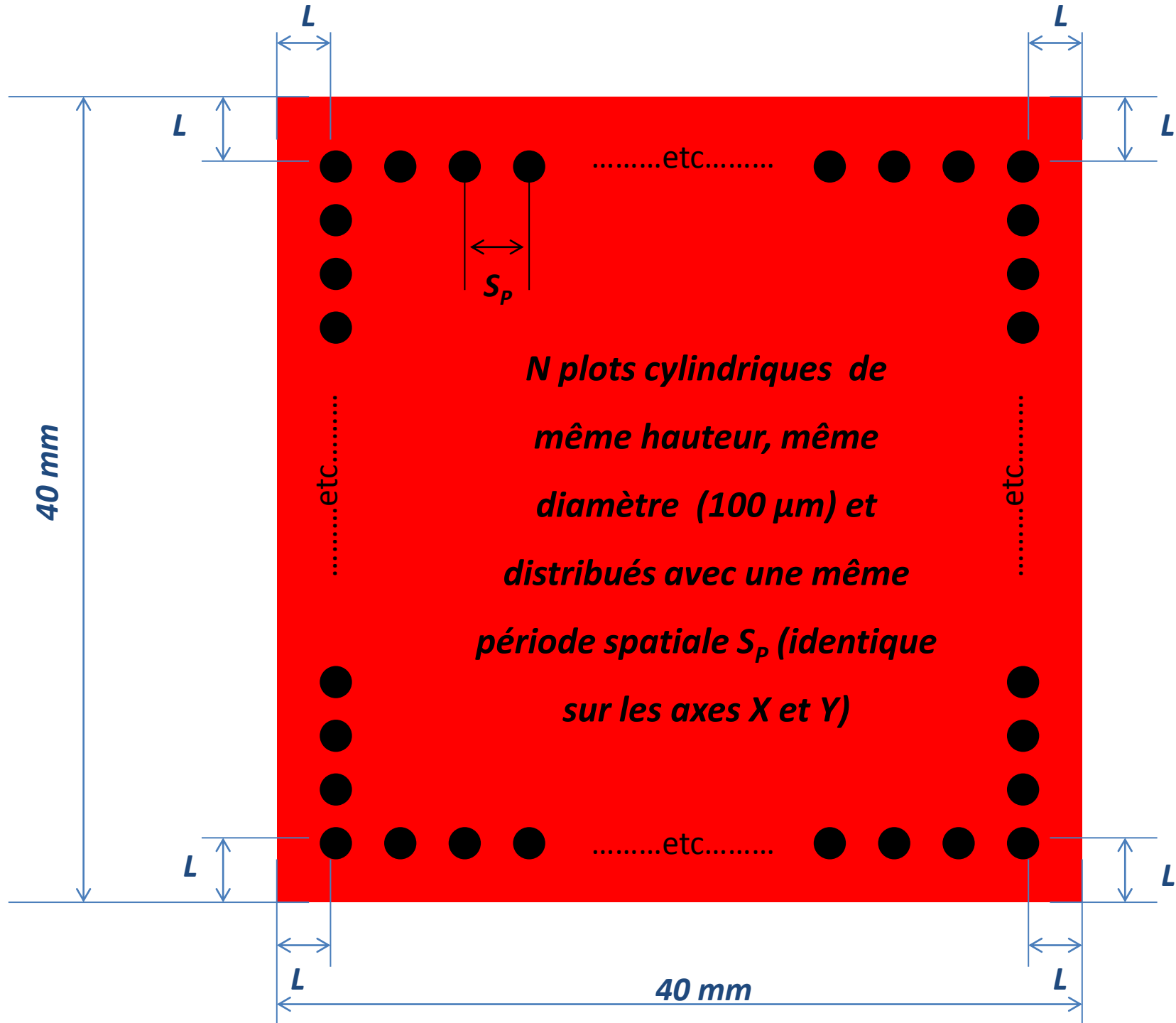


Réalisation de 8 surfaces texturées disposées sur 4 wafers (2 surfaces / wafer) :

- les surfaces texturées sont disposées comme indiqué sur le schéma ci-dessous.
- toutes les surfaces correspondent à des plans lisses sur lesquels se trouve des plots cylindriques de même diamètre et de même hauteur : la définition générale des surface se trouve en page 2.
- les surfaces texturées et leur emplacement sur les 4 wafers sont définis en page 3
- un téflonage est nécessaire à l'issue de la réalisation des surfaces (afin de faciliter le démoulage car nous réaliserons un moule en silicone de ces surfaces)
- à l'issue de la réalisation des surfaces : découpage de ces dernières





4 wafers contenant chacun 2 surfaces texturées de 40x40 mm² : 8 surfaces nommées A à H

- wafer n°1 : surfaces A et B
- wafer n°2 : surfaces C et D
- wafer n°3 : surfaces E et F
- wafer n°4 : surfaces G et H

	A	B	C	D	E	F	G	H
H (μm)	100	100	100	100	20	20	200	200
Sp (μm)	200	500	1000	1500	200	1000	200	1000
L (μm)	500	500	500	500	500	500	500	500
D (μm)	100	100	100	100	100	100	100	100
N	38416	6241	1600	729	38416	1600	38416	1600

Avec :

- H = hauteur des plots cylindriques
- S_p = période spatiale des plots (cf schéma *page 2*)
- L = distance à la frontière de la surface (cf schéma *page 2*)
- D = diamètre des plots cylindriques
- N = nombre de plots sur la surface